证券代码：300458　　证券简称：全志科技　　公告编号：2023-0321-005

珠海全志科技股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司《2022 年年度报告》全文于 2023 年 3 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日

证券代码：300458　　证券简称：全志科技　　公告编号：2023-0321-003

珠海全志科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 630,016,738 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全志科技	股票代码	300458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡雪鹏	王艺霖	
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号	
传真	0756-3818300	0756-3818300	
电话	0756-3818276	0756-3818276	
电子信箱	ir@allwinnertech.com	ir@allwinnertech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司目前的主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品满足消费、工业、车载领域的应用需求，产品广泛适用于智能硬件、智能家电、智能物联网、智能汽车电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场。

（二）主要经营模式

采购及生产模式，公司采用 Fabless 模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商生产各类终端电子产品。

研发模式，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟 IP 资源，及时为目标市场客户提供有特色竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。

（三）经营情况

1.主要芯片产品的类别

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的定义，公司所处行业属于“C 制造业-）39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)，公司所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业-）652 集成电路设计”。根据《国家重点支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于“一、电子信息-）(二)微电子信息 -）2 集成电路产品设计技术”。

2.国内外主要同行业公司

国内外主要同行业公司：联发科、晶晨股份、瑞芯微等。

3.主要芯片的基础架构

公司一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合 SoC、智能电源管理芯片、无线互联芯片以及相关软硬件的研究与应用技术开发。为了提高研发交付能力和加快产品迭代速度，坚持不断建设和完善各种技术平台和各种产品平台。在芯片设计层面，搭建了兼容不同核数、不同算力、不同应用需求的 SoC 设计技术平台；在系统设计层面，形成了信号和电源完整性、热设计、可制造性设计的板级设计技术平台；在基础软件层面，具备了基于 RTOS、Linux、Android 三类操作系统的软件设计技术平台；在应用层面，积累了面向不同应用领域的产品开发平台。整个 SoC 产品包的基础架构示意图如下：

4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例

产品大类	产品系列	主要型号产品	主要应用领域	应用示例
智能终端应用处理器芯片	R 系列	R16、R328、R329、R818、MR813	智能音箱、智能白电、扫地机器人、3D 打印机、词典笔等	天猫精灵、小米、小度等品牌的智能音箱； 美的、海尔等品牌的智能空调； 小米、海尔等品牌的智能冰箱； 石头、云鲸、小米、追觅、乐动、美的、海尔、Shark 等品牌的扫地机； 创想三维 3D 打印机、小米喷墨打印机等； 科大讯飞、作业帮词典笔；
	V 系列	V3、V526、V533、V536、V831、V851、V853	智能安防摄像机、低功耗电池摄像机、多目枪球摄像头、行车记录仪、运动相机、智能扫描笔及泛视觉 AI 产品等	创维小湃超高清摄像机； 捷渡智能行车记录仪； EKEN 低功耗门铃、低功耗摄像机等； 得力人脸考勤机等；
	H 系列	H3、H6、H313、H133、H616、H700、H618	智能机顶盒、智能投影商业显示、云解码、多屏互动等	腾讯－创维极光盒子、天猫魔盒； longTV 等海外运营商机顶盒； 创维投影、绿联办公投屏等； 创维小湃拍拍 4K 高清投屏器；
	A 系列	A33、A64、A100、A133、A133P	平板电脑、电子相册、教育设备、电子书等	Positivo、Aura、Multilazer、GP、GEL、loggicom 等品牌的平板；
	F 系列	F1C100S、F1C200S、F133	车载仪表 / 播放器、人机交互智能控制 HMI、视频机等	JVC & Kenwood 后装车机、公牛智能开关面板等； 爱玛电动车仪表、贝斯特电梯面板 HMI、富士康产检设备 HMI；
	T 系列	T3、T7、T5、T113	智能座舱、辅助驾驶、智慧工业、行业智能、智能电网等	佛吉亚中控车机；长安汽车智能驾舱；一汽全景泊车、上汽荣威全景泊车等； 南瑞继保电力二次保护设备、汇川工业人机交互 /PLC 等； 国网电力集中器 / 能源控制器、南网电力网关；
	其他	B300、D1、B810	电子书、视频一体机、开发板等	小米多看电纸书、科大讯飞电子书、Risc-V 开发板等；
智能电源管理芯片	AXP 系列	AXP221S、AXP223、AXP707、AXP305、AXP858、AXP717、AXP313	提供智能的供电、电池管理等功能，与主控芯片配套使用	-
无线通信产品	XR 系列	XR8052、XR819、XR829、XR872、XR806	智能家电、智能早教机、儿童机器人、智能机器人、低功耗 IPC、无线图传、智能门铃等；	小谷智慧点读笔、360 低功耗门铃、Anker 低功耗门铃等； TP-Link 无线智能可视门铃；
语音信号芯片	AC 系列	AC107、AC108、AC101、AC102	提供高集成度的语音信号编解码、信号转换等功能，与主控芯片配套使用	可穿戴设备；

5.新技术的发展情况和未来趋势

1）AI

人工智能，一般而言是对人的意识和思维过程的模拟，但目前已逐渐超出类人的概念，像把对结构的认知抽象、识别和匹配成各种模式的机器思维发展，利用机器学习和数据分析方法，补充和增强人类的思维能力。

AI 将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活会带来革命性的转变。可以认为，AI 是一个重要的生产力工具，AI 通过与各行各业结合，赋能各行各业。在自动驾驶、智能家居、安防监控、机器人、医疗设备、智慧课堂等新兴行业中，人工智能的技术创新和应用落地是行业智能化的推手。此外，AI 交互、AI 创作等应用场景发展迅速，如自然语言处理工具 ChatGPT 的问世 ，有望进一步推动行业智能化程度不断提升。

AI 技术必须具备三个要素：算法、数据、算力。近年来的 AI 蓬勃发展，主要是得益于大数据的累积以及 AI 专用算力的大幅增强。过去 10 年，AI 领域主要的算力载体是以国外芯片厂商提供的 GPU 设备为主，广泛应用于与 AI 相关的云端产品。而端侧嵌入式 AI 算力载体从 CPU、GPU、DSP 发展到 ASIC 架构，推动了基于深度学习的语音识别、人脸识别、图文识别、AIGC、目标检测、超分辨率 、ADAS 等技术的广泛应用。从算法层面，模型算法架构持续迭代，Transformer 神经网络结构逐渐成为自然语言处理领域的主流，如 ChatGPT 是其应用之一，主要用于云端产品，各算法厂商开始尝试应用到端侧产品，对端侧算力性能提出了更高的要求，这将推动 AI 算力的发展。从 AI 算法模型到端侧 AI 部署应用的落地，需要解决很多技术问题，如模型转换、量化、推理框架、算子融合、算子适配(自定义算子开发）等等。这不仅需要性能优越的算法模型以及可靠的高性能低消耗(低带宽低内存低功耗)硬件加速器，还需要通过 AI 编译器把算法模型转化成硬件设备能识别的表达式进行算法部署，再应用到具体的应用场景，满足用户的体验需求。在算法部署过程，算法开发应用算子级 API 和网络级 API、支持量化感知训练模型导入等加速算法开发效率和应用落地效率。

2）8K

8K 技术是一种视频技术系统名称，包括前端设备、编码压缩、网络传输、播放设备和平台应用等方面，还要同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围等多个维度技术，8K 取自用户最直接的观感、也是最重要的技术属性：分辨率，即 7680×4320(约 3386 万像素)，是 4K 分辨率(3840×2160，约 829 万像素)的 4 倍。8K 的超高清视频能够给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验，是互动式视频、沉浸式视频、VR 以及云游戏发展的基础。

信息视频化、视频超高清化是全球信息产业发展的大趋势。近几年来，CES 上超高清技术已成为智能终端与显示产品中的必备项，出现在游戏/会议/智能家居/摄影拍摄等各类应用场景中。随着 OLED、Mini/Micro LED 等背光显示技术走向成熟，电视突破高画质也变得更加轻松，央视春晚、北京冬奥会及多项赛事均已实现 8K 转播。

8K 对视频编解码性能提出了更高的要求。在视频编解码标准上，国外的 AV1 和 H.266，国内的 AVS3，均基于 8K 分辨率而定义，这些新的视频编解码标准通过技术底层的设计改变，提高视频流的压缩率，降低码流存储容量和传输带宽，让 8K 视频实时播放切实可行，奠定了 8K 视频播放的基础。

同时，8K 显示对分辨率/帧率/亮度/色域/色深/色准/刷新率/分区控光等诸多显示技术都提出巨大挑战。当下阶段，8K 编解码技术先行，结合 SR/HDR/MEMC 等算法提升画质是短期内的技术主线。

随着 4K 技术、产品的逐步成熟和日渐普及，会很大程度上推动 8K 技术以及相关产品的发展，加上医疗健康、安防监控、工业可视化、智能交通等超高清新业务对 8K 高清显示的需求增长，以及国家政策的扶持，8K 技术将持续突破技术短板，进入产业链加速成熟的阶段。

3）RISC-V

RISC-V 是一个基于精简指令集(RISC)原则设计的开源指令集架构，秉承简单有效的设计哲学，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。RISC-V 指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人任何企业设计、制造、销售 RISC-V 芯片和软件。RISC-V 能满足从微控制器到超级计算机等各种尺寸的处理器，支持从 FPGA 到 ASIC 等各种实现，能高效地实现各种微结构，支持大量的定制与加速功能，能和现有软件栈与编程语言很好的适配。RISC-V 技术标准的维护和推广由总部位于瑞士的 RISC-V 国际基金会持续负责，以保证 RISC-V 的开放和中立，技术供应稳定安全。

根据 Semico Research 的研究，预计到 2025 年，采用 RISC-V 架构的芯片数量将增至 624 亿颗，2018 年至 2025 年复合增长率高达 146%。2022 年 12 月在 RISC-V SUMMIT 上，RISC-V 国际基金会 CEO Calista 女士宣布市场上量产的 RISC-V 处理器已经达到 100 亿颗。

RISC-V 架构将成为未来智能物联网时代一个重要的处理器指令集架构。目前，硬件规范、软件生态都在持续完善中。在 RISC-V SUMMIT 上，RISC-V 国际基金会 CTO 公布 2022 年度基金会已经批准了 6 项标准规范，其他 10 余项将在 2023 的 Q1 陆续批准发布。这些技术通过 RISC-V 基金会 81 个技术组成员的协作实现，他们专注于快速增长的各市场的技术领域，例如安全、片上系统基础设施、汽车和 AI/ML。同时，RISC-V 软件生态系统进行了重大更新，Google 宣布在 Android 开源项目(AOSP)上支持 RISC-V 架构，RISC-V 社区的技术团队为更多软件项目提供了 RISC-V 支持，支持 RISC-V 架构的开源清单越来越长。全志科技时刻关注着 RISC-V 架构的技术进展和行业动态，根据实际情况开展市场活动，目前多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。D1 系列芯片是 AP 级别的 RISC-V 架构计算平台，面向高清解码市场，多个细分领域的产品已进入大规模量产。搭载 D1 芯片的哪吒开发板成为国内外热门、主流的 RISC-V 开发平台，国内外多所高校、科研机构基于 D1 系列进行 RISC-V 架构的系统及应用的研究。在智慧视觉领域，全志推出了全新搭载 RISC-V 处理器的 V85X 系列平台，多家客户已经进入大规模量产，相关的编码产品已经进入市场。继高清视频、智慧视觉两个市场相关产品推出后，全志持续深耕 RISC-V 架构，针对智能语音场景推出搭载 RISC-V 处理器的 R128 系列芯片，为整个行业持续注入动力。

4）FinFET

平面工艺演进至 22nm 后，难以再度延伸摩尔定律，因此具有三维立体结构的 FinFET 孕育而生。FinFET 称为鳍式场效应晶体管(Fin Field-Effect Transistor)，不同于传统晶体管的平面结构，FinFET 采用了类似鱼鳍的 3D 架构，可以让晶体管的面积大幅度缩减，提升速度的同时还能减少漏电流。

FinFET 的技术要求和制造设计费用都很高，主要体现在：①深槽刻蚀、窄填充、大角度高剂量注入 PN 结隔离等工艺，给一致性、稳定性、可靠性、良率带来挑战，高性能与低漏电的平衡难以把控。②制造复杂性导致设计成本是 28/22nm 平面工艺的几倍到几十倍，光罩和晶圆成本增加数倍。

因为资金投入巨大的原因能跟进的晶圆代工厂越来越少，全球只有 TSMC、Intel、Samsung 等少数晶圆厂商具备 FinFET 工艺的量产能力。在工艺制程的适配性上，追求高性价比的中小规模芯片继续停留在 40/28/22nm 等平面工艺，而超高性能要求的手机、HPC 等应用已进入 5/3nm 等先进节点，台积电宣布其 3nm 技术已成功进入批量生产，并透露 2nm 工程正如期进行；Samsung 宣布成为全球首家开始量产 3nm 制程芯片的厂商，采用 GAA 工艺。14/12/7nm 的产能将释放给中高性能需求的芯片。

在智能物联网相关领域，目前仍以 40/28nm 制程工艺为主，为满足日渐提升的应用需求，需要有更高算力、更低功耗的系统性能、采用更先进更低成本的 FinFET 制程将是一个很好的选择。

5）工业/车规质量

芯片一般按温度适应能力及可靠性要求，大致分为四类：商业级、工业级、车规级、军工级。其中工业应用场景最为复杂、多样，包括工厂自动化与控制系统、电机驱动、照明、测试和测量、电力和能源等传统工业领域，以及医疗电子、工业运输、楼宇自动化、显示器及数字标签、数字视频监控、气候监控、智能仪表、光伏逆变器、智慧城市等，各种应用场景对芯片的设计、验证、生产、测试和应用各环节的质量要求都很高，难度很大。车规应用对环境要求、抗振动冲击、可靠性、一致性、寿命等方面的要求更为严苛，而且还要满足所有“车规认证”要求。目前，业界较为通用的芯片车规认证标准主要有可靠性标准 AEC-Q 系列、功能安全标准 ISO 26262。随着自动驾驶的广泛应用，车规级芯片的质量要求会越来越高。

对此，公司在 2022 年导入了 IATF 16949 车规质量管理体系，应用 IATF 16949 五大质量工具，进一步提升了公司的质量管理能力，保障产品和服务的高品质交付；导入了 ISO 26262 功能安全体系，已经在 ISO 26262 功能安全的关键技术上取得了重大突破，为公司拓展车规及工业级应用领域的业务提供强力保障。

（四）报告期内经营情况

2022 年受国际经济形势、国内公共卫生事件等多重因素影响，下游消费市场需求下降。2022 年公司实现营业收入 151,413.22 万元，比上年同期下降 26.69%，归属于母公司所有者的净利润 21,105.97 万元，比上年同期下降 57.31%。公司密切关注外部环境变化，同时积极做出应对，通过强化技术的自主研发，在先进工艺、大算力、高可靠性车规技术、多媒体处理系统、WiFi6 等领域加大投入，通过协同产业链合作伙伴深耕产品包竞争力，在既有的应用领域的基础上，积极拓展汽车、工业、智能机器人、智慧显示、智能家电领域的新应用，为后续业务发展奠定基础。

1.用技术创新提升产品竞争力

面对日益复杂的经营环境，公司持续强化核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主知识产权壁垒。同时和产业链合作伙伴深度联动，围绕客户的需求和场景，持续深挖技术竞争力，推动产品包的迭代升级，持续对智能终端的相关技术进行迭代升级。围绕汽车、工业、智能机器人、智慧显示、智能家电等领域，在先进工艺、大算力、SoC 系统架构、低功耗、高可靠性车规工艺、超高清视频编解码、软件操作系统、无线互联技术等技术持续精进，为产品的成本、功耗、性能竞争力提供有效支撑。

5G、千兆网络的普及，推动了 WiFi6 的应用需求增长，同时对视频的需求也呈现更高分辨率、更高清晰度的趋势。公司加速投入研发资源，储备 WiFi6 技术。同时，随着大数据和 AI 时代的到来，不仅处理的数据量规模日益提升，同时对能效比的要求也越来越高。而为满足日益增长的算法应用需求，公司深入分析算法应用场景，在大算力 & 大数据总线架构、多核异构、AI 专用处理器、低功耗系统架构、先进工艺平台等方向实现技术突破。公司积极掌握和储备先进工艺技术，持续在先进工艺上的面积、性能、功耗优化上积累经验，为后续的产品档位突破蓄能。同时在既有的工业级和车规级技术的基础上，围绕 ISO26262 车规质量要求，进一步提高质量管控和交付体系。

在丰富的技术储备和统一的产品集成开发模式下，公司可快速推出 SoC、PMU、WIFI、ADC 等高品质产品，搭配自主研发的通用操作系统 Melis、Tina，以及对 Android、OpenHarmony 系统的快速适配与优化完善，可向客户提供 SoC+的套片组合解决方案，大幅降低客户研发成本。

2.持续拓展智能产品线，推动智能化迭代升级

报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下：

(1)AIOT 领域

智能音箱市场，公司与行业头部一线标杆客户保持产业深度合作，R 系列芯片产品已实现带屏、无屏音箱全面量产。公司推出了内置 WiFi 的 R 系列低功耗智能语音芯片新品，持续投入面向可移动智能音箱场景的专用技术研发，以不断提升智能音箱产品的用户体验。同时，公司布局高性能 AI 芯片，为智能语音技术落地提供更强算力，不断深化在智能音箱领域的投入探索，与产业上下游持续推动产业共同发展，打造更多标杆产品以满足终端消费者需求。基于智能语音的技术积累及生态布局，公司已与智能家电、扫地机器人、陪伴机器人、AI 教育(学习机、词典笔)等领域重要客户深度合作，拓展智能硬件产业多元化发展，推动智能硬件产品加速普及和消费升级。

智能清洁机器人市场，随着国民生活水平的提高，年轻群体的消费呈现高潜力趋势，以扫地机/手持洗地机为代表的清洁电器增长势头明显。随着自主导航产品的量产普及，下游客户又针对扫地机避障不够智能的用户痛点，陆续推出了集成 AI 物体识别及避障的中高端产品，避障能力大幅提升，促使中高端产品份额大幅增长。面向扫地机产品呈现的无感清洁/功能复合/智能升级/体验升级/场景多元等趋势，公司推出了面向中高端扫地机的 MR 系列芯片新品。公司持续布局多核异构架构，集成底盘运动控制芯片功能等专用模块，继续围绕激光、视觉、ToF&DToF、线激光、双目等传感器品类的中高端扫地机产品应用需求，持续推动新技术的落地应用，持续保持在该市场的主要供应商优势地位并提升份额。面向海外新兴的割草机等智能清洁机器人产品，公司已提前布局相关技术，并与品牌客户开发产品，推动相关市场业务的落地。

智能家电市场，随着家电智能化技术的日益成熟和消费者习惯的逐步形成，家电行业全屋智能化已呈现明显趋势，智能语音、智能屏显、全屋互联等功能在各种家电渗透比例快速提升。公司作为智能家电领域的深度参与者，持续深耕高集成度 SoC、智能语音、自动感知、互联通信等技术，并和产业链合作伙伴紧密合作，围绕家电智能化升级的需求，推出系列化解决方案。公司面向智能家居场景相继推出 R 系列芯片新品应用方案，已获得家电和互联网智能家居头部客户的认可和定点合作。公司将持续完善全屋智能生态合作圈，促进相关市场业务拓展。

智能视觉市场，结合安防市场产品发展趋势，公司在智能图像引擎、高清视频编码及神经网络处理器技术、低功耗极速快启等核心自研技术上加大投入，已成功在多家行业头部客户中完成新一代视觉芯片 V853 的全面落地量产。公司与多家消费类知名客户深入合作，涵盖如枪球摄像机、超广角摄像机等各类多目智能视觉产品，打造了全新的视觉安防智能联动体验，进一步提升安防产品综合竞争力。同时，新一代视觉芯片已在运营商完成芯片入库认证，为公司下一步发力运营商市场取得坚实基础。在智能人脸门锁产品上，公司与多家 IDH 深入合作，实现多平台全面量产，取得了良好的市场反映，新产品已在 IDH 完成导入量产，将进一步提升公司在该市场的影响力。公司加大 V853 AI 开源开发板在国内外市场及开发社区的推广运营，已在各个细分领域客户实现布局及落地，并取得良好反馈，公司将围绕智能视觉领域行业上下游生态形成更紧密的互动及合作，依托公司在线体系，流程化支持服务各类行业客户及开发者，持续扩大市场份额及品牌影响力，为未来端侧智能视觉芯片持续迭代打造市场及客户基础。　（2）智能汽车电子领域

智能汽车电子市场，公司深耕芯片高可靠性架构、高清视频编解码以及人工智能技术在智能座舱以及智能辅助驾驶应用领域的落地，在多核异构、hypervisor、硬件虚拟化、ISO 26262 等方面进行了重点布局。产品涵盖了智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等形态，同时针对汽车电动化的需求，围绕新能源汽车周边充电设备与生态链合作伙伴共同展开合作。公司针对智能车载人机交互需求，发布 T113 芯片产品及解决方案，已在车载人机交互和仪表类应用落地。同时，搭载公司产品的 AR-HUD、APA 类智能化产品已与前装市场客户合作实现量产上市。为满足客户域控性能诉求，公司投入对高性能车载平台化产品的研发。公司将逐步推进产品序列化布局，并根据客户需求提升产品性能，更好的服务客户，服务市场。

（3）智能工业领域

智能工业市场，工业智能化和国产化已成为国内制造业转型升级的方向。公司深耕各类工业人机交互、控制器、网关、边缘计算、机器人等应用场景，在芯片质量、功耗优化、系统安全和实时性等关键技术锐意突破，并推出了 T 系列 AI 处理器新品。公司在电力和工业自动化市场继续深化与头部客户的合作，在电力集中器市场提升工业级产品方案市场影响力，与标杆客户打造的 easy 系列工业 PLC 控制器获得良好市场反馈，成为工业客户相关产品线的主力平台。公司在智能工业市场的大规模量产为公司产品在工业级可靠性、安全性、稳定性和客户应用场景等各方面积累了宝贵经验和技术积累，公司将基于这一基础推动下一代芯片产品及方案的推出。

（4）智能解码显示领域

智能显示市场，公司面向大屏显示、微媒体解码、行业显示及各类新的显示应用领域，不断深耕 4K/8K 解码、画质优化、新一代视频标准等技术及规范，在国内海外零售机顶盒、多屏互动、无线互联车载娱乐系统、人机交互界面(HMI)等市场发挥重要影响力。公司积极进行“智慧屏”产品规划及研发，布局智能投影、激光电视、智慧屏等新兴市场，并推出了智慧屏芯片 TV303，后续将逐步在智能电视、智能投影、智能商显领域投入量产。

（5）通用智能终端领域

公司基于 A100/A133/A133P 系列主力通用智能终端芯片产品，紧跟安卓最新生态的升级迭代，不断提升系统安全性及产品体验。同时，面向多样化及长尾的全球市场，公司积极布局 Linux 生态，充分发挥公司通用智能终端产品在集成度及通用性上的优势，公司积极拓展通用智能终端相关衍生市场，布局包括电子相册、教育设备等产品，均取得良好的市场反馈。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,558,993,564.05	3,486,343,695.69	2.08%	2,755,823,719.39
归属于上市公司股东的净资产	2,957,688,175.24	2,804,693,343.53	5.45%	2,343,397,241.44
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,514,132,177.25	2,065,356,818.73	-26.69%	1,505,485,852.54
归属于上市公司股东的净利润	211,059,746.57	494,458,759.71	-57.31%	204,754,125.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,397,837.17	364,042,222.88	-69.95%	82,855,758.97
经营活动产生的现金流量净额	-28,969,185.02	356,785,003.35	-108.12%	391,938,843.24
基本每股收益(元 / 股)	0.34	0.79	-56.96%	0.33
稀释每股收益(元 / 股)	0.33	0.78	-57.69%	0.33
加权平均净资产收益率	7.39%	19.30%	-11.91%	9.05%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	415,726,312.92	416,295,543.95	339,094,435.75	343,015,884.63
归属于上市公司股东的净利润	76,824,546.32	126,207,875.26	18,992,752.35	-10,965,427.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,366,321.44	49,663,024.11	14,501,889.40	-32,133,397.78
经营活动产生的现金流量净额	-89,832,030.80	-6,500,560.12	-111,735,071.21	179,098,477.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张建辉	境内自然人	8.75%	55,095,389.00	41,321,542.00		
丁然	境内自然人	7.88%	49,654,879.00	37,241,159.00		
侯丽荣	境内自然人	7.67%	48,340,870.00	36,255,652.00		
龚晖	境内自然人	6.40%	40,323,170.00	0.00		
蔡建宇	境内自然人	4.01%	25,233,970.00	0.00		
唐立华	境内自然人	2.20%	13,858,473.00	0.00		
PAN YA LING	境外自然人	1.92%	12,077,539.00	0.00		
李龙生	境内自然人	1.52%	9,574,871.00	7,181,152.00		
国泰君安证券股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,670,934.00	0.00		
薛巍	境内自然人	0.64%	4,038,585.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2022 年年度报告》。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉

2023 年 3 月 20 日

证券代码：301000　　证券简称：肇民科技　　公告编号：2023-010

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计 10 名，代表有表决权的公司股份数合计为 59,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.3269%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 50400200 股，占公司有表决权股份总数的 52.5000%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,433,800 股，占公司有表决权股份总数的 9.8268%。

（二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。

（三）公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

（四）北京德恒(杭州)律师事务所　陆曙光律师、邱馨瑶律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果：同意 59,829,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决结果为：同意 2,229,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7798%；反对 4,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 59,829,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决结果为：同意 2,229,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7798%；反对 4,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案获得通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 59,829,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决结果为：同意 2,229,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7798%；反对 4,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2202%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒(杭州)律师事务所

2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日

证券代码：600139　　股票简称：*ST 西源　　公告编号：临 2023-036 号

四川西部资源控股股份有限公司 关于股票终止上市暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票不进入退市整理期交易。

●公司股票将于 2023 年 3 月 27 日终止上市暨摘牌。

●2023 年 3 月 14 日公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》的议案